

窒素フロー装置
N₂ Flow
Soldering System

GFL Series GFL-350N

鉛フリー対応
窒素はんだ付け装置
N₂ Flow Soldering System
available for Lead-free



すだれの無い窒素ドーム構造
N₂ tunnel structure without blocking curtains



取り外し可能なドームカバー
Removable tunnel cover

新開発の窒素ドーム構造とクリーンなはんだ付け環境

Newly-developed N₂ tunnel structure and clean soldering circumstance

- 部品高さ100mm対応のすだれの無い、解放されたドーム構造
- 窒素ドーム内にミスト回収とクリーンな基板冷却機構を内蔵
- 出入口にドーム内圧力調整構造を持ち安定した低酸素濃度
- 予熱部は遠赤ヒータと温風循環を持ち低酸素濃度で加熱
- はんだドross発生を低減し、はんだボール発生を抑えた噴流機構
- はんだ槽部の反り防止ユニットはドームを開ける事の無い外部操作機構(OP)
- はんだ付け部のピールバックポイント外部操作機構(OP)
- 二次元コードなどによる機種切替とトレーサビリティ対応(OP)
- Open tunnel structure without air block curtain, available for Max 100-mm-high components
- Inlet & outlet pressure control systems to maintain low O₂ level inside the tunnel
- Wave soldering system designed to reduce solder dross & solder ball generation
- Dipping-zone PCB warp prevention unit operable externally without need to open the tunnel (Option)
- Externally-operable peel-back point adjustment unit at dipping zone (Option)
- Mist collection and PCB cooling system embedded in the N₂ tunnel
- Low O₂ level preheat zone with far-infrared heater and hot-air circulation system
- PCB model changeover and traceability via 2D code, etc. (Option)



KOKI TEC CORP.

仕様項目 Specification Item	GFL-350	
	標準 Standard	オプション Option
基板サイズ MIN PCB Size (MIN)	50(W)×120(L)mm	—
基板サイズ MAX PCB Size (MAX)	350(W)×450(L)mm	—
基板厚さ PCB Thickness	0.6~2.0mm	—
搭載部品高さ Mounted Component Height	上面80mm以下・下面6mm以下 Top side: 80mm or less / Bottom side: 6mm or less	上面100mm Top side: 100 mm
ファイル数 Numbers of Files	200ファイル 200 files	二次元コードによる段替え Model changeover via 2D code
はんだ槽 Solder Pot	自動引き出し Automatic Roll-out System	一次ノズル特殊対応 Custom 1st nozzle available
はんだ容量 Solder Capacity	約420Kg(比重7.3時) Approx. 420kg (SG: 7.3)	—
窒素供給量 N ₂ Supply Amount	0.5MPa 330L/min	—
電源 Power Source	三相 200V±10% 34KVA(100A) Three-phase 200V±10% 34KVA(100A)	—
装置寸法 Outer Dimensions	4,850(L)×1,400(W)×1,665(H)mm	—
自重量 Entire Weight	約1,500Kg Approx. 1,500 kg	—

標準仕様 Standard Specifications

出入口チェーンフィーダコンベア Inlet & outlet chain conveyors	はんだ槽自動引き出し Automatic solder pot roll-out system
遠赤パネルヒータ Far-infrared panel heater	ミスト回収・基板冷却 Mist collection & PCB cooling systems
鋳物はんだ槽 Casting solder pot	酸素濃度計 Oxygen meter
搬送角度4.5° 4.5° conveyance angle	PLC・タッチパネル制御 PLC & Touch panel control
爪洗浄機構 Finger cleaning unit	メンテナンス用ノズル脱着工具 Nozzle mount/demount tool for maintenance

オプション Options

ピールバックポイント外部操作機構 Externally-operable peel-back point adjustment unit	出口平ベルトコンベア(への字タイプ) Outlet flat belt conveyor (Approx. chevron shape type)
はんだ槽部基板反り防止機構(外部操作) Externally-operable PCB warp prevention unit at dipping zone	入口基板停滞監視 Inlet PCB jam monitoring system
自動はんだ供給装置 Automatic solder feeder	出口基板停滞監視 Outlet PCB jam monitoring system
自動幅可変機構 Automatic width adjustment system	基板通過監視機構 PCB passing monitoring system
鋳物予備はんだ槽 Spare casting solder pot	QR/バーコード対応(受注時対応) QR/Barcode system (Non-retrofitable)
予備槽台車 Spare solder pot carriage	生産管理システム Production control system
バスライン変更 Changing pass line	
3灯式シグナルタワー Three-light signal tower	

販売代理店
Distribution Agent

株式会社 弘輝テック KOKI TEC CORP.

〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島10-7-6
TEL.048-862-8001 FAX.048-862-8005
10-7-6, Tajima, Sakura-ku, Saitama-city, Saitama
338-0837 JAPAN
Tel: +81-48-862-8040 Fax: +81-48-862-3337
<http://www.kokitec.co.jp>